

基板レスの一翼を担う「印刷→成形」による3D配線形成用ペースト 真空成型用Agペースト LS-610-1

Silver paste LS-610-1 for vacuum forming contributing to Substrate-less process, 3D wiring via [Printing → Formation]
 貢獻於無基材化作用, 由【印刷→成形】達成3D配線的真空成型用銀漿LS-610-1

特徴 Features/特徴

- シート上にAgを印刷→成形することで、3D曲面への電極、導電パターン形成が可能。
 Conductive pattern, electrode forming on 3D curved surface made possible by printing → forming Ag on sheet
 經由在薄片上印刷→成形銀, 使在3D曲面上形成電極, 導電圖形成為可能。
- 延伸時の断線、クラックが起こりにくい。
 Occurrence of cracks, line-breaks during stretching is unlikely/延伸時難以發生斷線, 龜裂。
- PCシートに直接印刷・硬化可能。(PC素材への浸食性なし)
 Possible to print/cure directly on PC sheet (No t corrosive to PC material)/可以直接印刷/固化在PC薄片上。(對於PC材料無侵蝕作用)

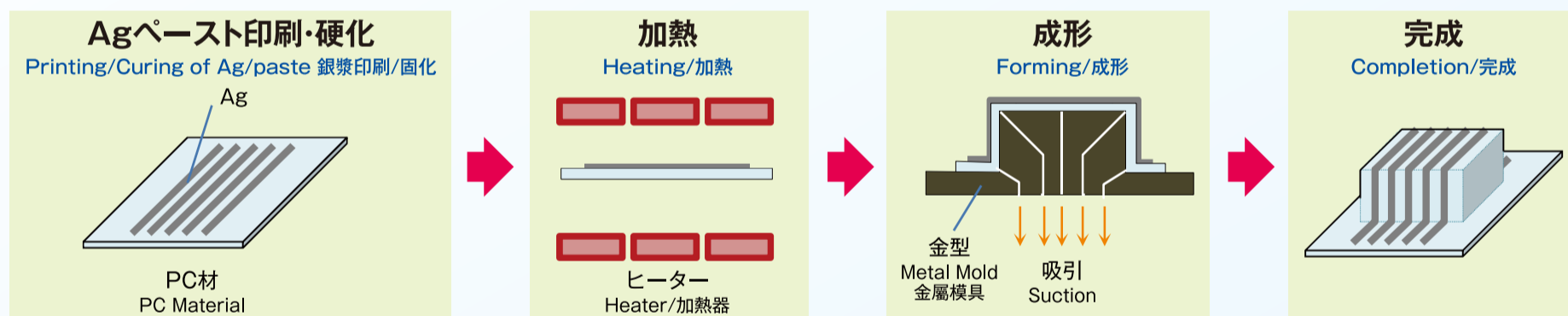
仕様 Specifications/規格

特性項目 Characteristic items/特性項目	NEW LS-610-1	備考 Remarks
粘度 (25℃) Viscosity/黏度	1100 dPa·s	VT-06 type VT-06型
硬化条件 Curing condition/固化條件	100℃×30min	熱風循環式乾燥炉 Hot air circulating drying oven/熱風循環式乾燥爐
印刷性 Printability/印刷性	100μm	線幅 Line width/線寬
密着性 Adhesion/密着性	100/100	PET、PC
面積抵抗値 Sheet Resistivity/面積阻抗值	120mΩ/□	膜厚10μm換算 Converted as 10μm thickness/膜厚10μm換算

用途 Application/用途

- 樹脂筐体の裏側への配線、センサー電極形成など
 For the forming of sensor electrodes, wiring to the underside of resin chassis, etc. /在樹脂殼體的背面上形成配線, 傳感器電極等

摘要イメージ図 A forming condition setting example/摘要圖片



成形物 Molded Product/成型物

- A4サイズPCシート野線パターン成形例 Forming example of guideline pattern A4 size PC sheet/A4 尺寸PC薄片格線圖案成形例子

